Al₂0₃/Si0₂界面ダイポール層強度の温度依存性と各酸化物の密度の相関

 $Correlation \ between \ the \ temperature \ dependence \ of \ Al_2O_3/SiO_2 \ interface \ dipole \ layer \ strength$

with the density of oxides

東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 ⁰濵口 高志、喜多 浩之

Dept. of Materials Engineering, The Univ. of Tokyo, ^oTakashi Hamaguchi and Koji Kita E-mail: hamaguchi@scio.t.u-tokyo.ac.jp

[背景] High-k 材料では熱酸化 SiO2 との界面におけるダイポール層強度に比較的大きな温度依存性が見 られることがあり、Al₂O₃/SiO₂界面では 2-3mV/K と大きな値が報告されている^{[1][2]}。広い温度範囲での 動作を想定したデバイス応用¹³においては、単にダイポール層の強度だけでなく、このような異常な動 作温度依存性の制御が不可欠である。今回は SiO2 の形成条件や Al2O3 のアニール条件を変え、様々な 膜質を持つ酸化膜で界面をつくり、酸化膜の膜質とダイポール層強度の温度依存性の相関を検討した。 [実験] 電子線蒸着法で堆積した Si を熱酸化して得た SiO2 膜を SiO2^{depo}、Si 基板の熱酸化膜を SiO2^{themal} とする。(i)SiO2depo、(ii)Al2O3/SiO2thermal、(iii)Al2O3(PDA800℃)/SiO2depo/SiO2thermalの各構造をSi基板上に有 する3種類の試料を作製した。Al₂O₃はスパッタリング法で室温成膜した。(i)と(iii)については堆積Si の酸化温度(T_{oxidation})を 800℃、1000℃、1150℃としたものを、(ii)については Al₂O₃ のアニール温度 (T_{PDA})を 800℃または 1150℃としたものをそれぞれ用意した。SiO₂と Al₂O₃の密度をそれぞれ(i)と(ii) を用いて X 線反射率測定法(XRR)で推定した。また FTIR により Si-O-Si 非対称伸縮振動の TO モード の赤外吸収ピーク(v si-o-si)を(i)の基板裏面の酸化膜を除去した後に評価した。さらに、Al2O3 膜を 1~2 nm に薄膜化した(iii)を用いて Al₂O₃/SiO₂ 界面近傍の Al と Si の化学状態を XPS で評価した。 [結果] Fig.1 に Al₂O₃/SiO₂ 界面のダイポール層強度(V_{dipole})の測定温度依存性を示す。V_{dipole}の値は、Al₂O₃ 膜厚(d_{Al203})の異なるいくつかのキャパシタ(iii)で得たフラットバンド電圧(V_{FB})の d_{Al203} = 0 への外挿値 と、Al₂O₃のない(iii)の V_{FB}との差分より求めた。Fig.1の傾きが示す温度係数と,XRR の結果から推定 した SiO₂^{depo}の密度との相関を Fig. 2 (a)に示す。既に報告している Al₂O₃/SiO₂^{thermal} 界面の結果^[1]も比較 のために示した。堆積 Si の高温酸化で得られる SiO2^{depo}および SiO2^{thermal}上でのみ、ダイポール層強度 に正の温度係数が見られたが、これらの SiO2 膜は共通して低密度(~2.2g·cm⁻³) である。一方で堆積 Si の低温酸化で得られる SiO2^{depo}上ではダイポール層強度に顕著な温度依存性は見られないが、これらの 膜は相対的に高密度(~2.5g·cm⁻³)と推定された。尚,酸化温度による密度の違いは,SiO₂の赤外吸収 スペクトル(Fig.3)において高密度化⁽⁴⁾またはサブオキサイド化⁽⁵⁾を示唆する v si-o-siの低波数側へのシフ トの大小が見られたことと矛盾しない。また各酸化温度における密度の推定値は既報の値⁶⁰とおおよそ

一致している。次に、Al₂O₃の PDA 温度が 800℃と 1150℃の 2 つの場合を比較すると, Fig. 2 (b)に示す ように界面ダイポール層強度に正の温度係数が見られるのは 800℃の場合のみであったが, XRR によ り Al₂O₃ 膜の密度を推定したところ、800℃アニール後の Al₂O₃ 膜は、1150℃の場合よりも 25%程度低 密度と推定された。以上より、Al₂O₃/SiO₂ 界面ダイポール層強度に顕著な温度依存性が見られるのは、 SiO₂ と Al₂O₃ の双方が低密度膜である場合に限定されることが示唆された。この結果は界面ダイポー ル層強度の温度依存性の制御のための材料設計指針となる。一方、Al₂O₃/SiO₂ 界面近傍での Al 2p3/2 と Si 2p3/2 の内殻 XPS の形状には堆積 Si の酸化温度に応じた違いはみられず, 界面近傍の Si や Al の化 学状態や混合状態はダイポール層強度の温度依存性の大小に影響しないことが示唆される。

[参考文献] [1] S. Nittayakasetwat and K. Kita, J. Appl. Phys. **125**, 084105 (2019). [2] 濱口, 喜多, 2018 春季応用物理学会(17a-F206-9). [3] 濱口, 喜多, 2018 秋季応用物理学会(21p-145-10). [4] C. Martinet and R. A. B. Devine, J. Appl. Phys. **77**, 4343 (1995). [5] K. T. Queeney et al., J. Appl. Phys. **87**, 1322 (2000). [6] M. Miyasaka, et al., Jpn. J. Appl. Phys. **37**, 1076 (1998).



Fig. 1. Temperature dependence of $\Delta V_{dipole}^{T} (=V_{dipole}(T)-V_{dipole}@295K)$ of Al_2O_3/SiO_2^{depo} interface dipole layer strength. $T_{oxdation} = 800^{\circ}C(\blacktriangle)$ and $1150^{\circ}C(\textcircled{O})$. T_{PDA} was $800^{\circ}C$.







50 1100 1050 1000 Wavenumber (cm⁻¹)

Fig. 3. IR absorption spectra of SiO_2^{depo} films fabricated by thermal oxidation at different $T_{oxidation}$. For the comparison, the data for thermal-SiO₂ (grown at 1000°C) is also plotted.